

TO-220FP

TO-220FP (Full Pack) 是 TO-220 系列的全塑封版本，与传统 TO-220NIS 封装相比，它通过采用铜片结构并将封装厚度降低 2.8 毫米，从而对散热效率进行了优化。

应用

TO-220FP 适用于以下器件中的中到高压 MOSFET 和 IGBT：

- ▶ 开关电源
- ▶ 交流电转接器
- ▶ 电机驱动器
- ▶ 平板显示器

可靠性鉴定

Amkor 芯片封装采用成熟可靠的半导体材料。

- ▶ 温度循环：-55~150°C，500 次循环
- ▶ 高温偏置：150°C、1000 个小时
- ▶ 焊料浸渍：260°C/10 秒

测试服务

Amkor 为全部功率分立产品提供完全一站式的服务。我们有能力测试各种类型的功率器件，包括 MOSFET、双极型晶体管、IGBT、二极管和稳压器 IC/智能化电源器件。

- ▶ Amkor 的功率分立器件测试能力
 - ▷ 静态测试 (直流)
 - ▷ 动态测试 (交流、开关/Trr、电容/Rg)
 - ▷ 破坏测试 (电感负载/VSUS、I latch、电涌、隔离/VIL)
 - ▷ 热阻 (ΔVDS 、 ΔmV ，等等)
- ▶ 程序生成/转换
- ▶ 故障分析
- ▶ 可用的测试/处理技术
- ▶ 集成打标、外观检查和卷带式包装

特色

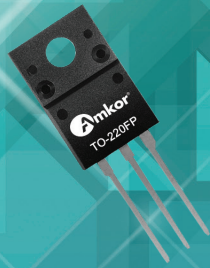
- ▶ 铜片互连，以提升散热效率
- ▶ 将标准 TO-220NIS 的贴装封装高度降低 2.8 毫米
- ▶ 一站式测试与包装服务
- ▶ 绿色材料：无铅电镀和无卤素模塑化合物

全新开发

- ▶ 更大/更高密度的引脚框架条带
- ▶ 环境友好的无铅焊膏

工艺亮点

- ▶ 无电镀裸铜引脚框架
- ▶ 互连：优化电气和热性能的铜片
- ▶ 电镀：100% 雾锡
- ▶ 打标：激光笔



TO-220FP

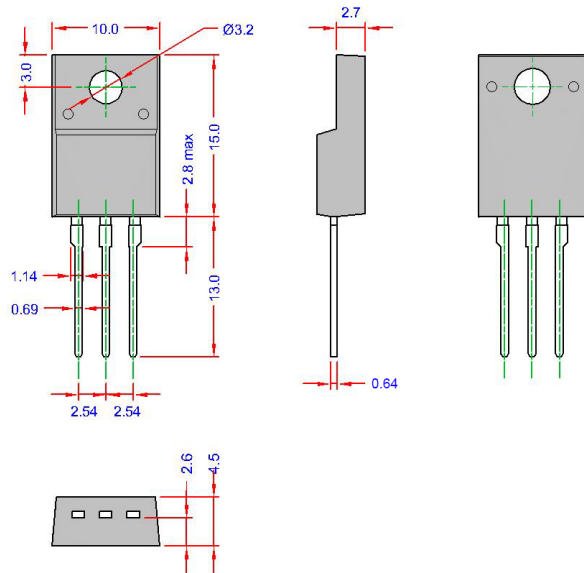
标准材料

- ▶ 引脚框架：裸铜
- ▶ 晶粒贴装：焊膏
- ▶ 互连：双铜片
- ▶ 模塑化合物：含卤素和无卤素

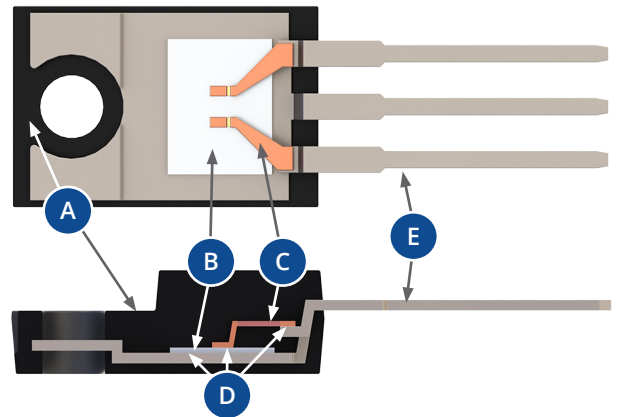
装运

- ▶ 管装或散装
 - ▷ 管装 = 每箱 1500 或 2500 件
 - ▷ 散装 = 每箱 500 件
- ▶ 条形码封装标签
- ▶ 直接代发货

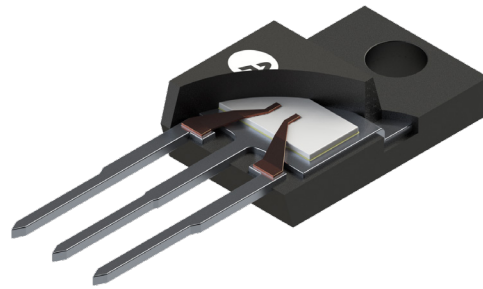
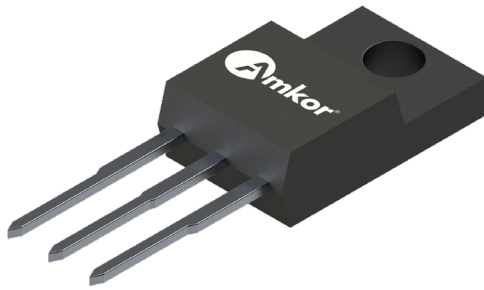
封装外形图



横截面



- A Mold compound
- B Die
- C Cu clip
- D Solder paste
- E Leadframe



访问 amkor.com 或发送电子邮件至 sales@amkor.com 以获得更多信息。

关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2020 Amkor Technology, Incorporated. 保留所有权利。DS610D-CN 修改日期：01/20

